

PGA-Carrier Serie 600 32.02 Einpreßtechnik PGA-Fassung Serie 546

- Bei den PGA-Carrier bleiben alle Leiterbahnen und Lötstellen im Sockelbereich sichtbar.
- PGA-Fassungen für Einpreßtechnik mit flexibler Einpreßzone.

Höchste Kontaktsicherheit durch Kontaktfeder aus Beryllium-Kupfer mit homogener Vergoldung.

Kontaktfeder

Material: Beryllium-Kupfer
Oberfläche: Nickel 2 – 3 µm,
Gold 0,25 µm, 0,75 µm

Hülse

Material: Messing gedreht
Oberfläche: Nickel 2 – 3 µm,
Zinn 5 µm (SnPb 90/10),
bei Serie 546 Zinn 1,5 µm

Isolierkörper hochtemperaturfest (HT)

Thermoplastischer Polyester glasfaserverstärkt,
selbstverlöschend nach UL94V0.

Temperatur

Betriebstemperatur -55 bis +125° C
Lötbeständigkeit 260° C, 10 Sekunden

Kontaktiefe

1,9 bzw. 2,4 mm bei sicherer
Kontaktgabe

Einsteckdurchmesser

min. 0,4 mm, max. 0,56 mm

Betriebsspannung

100 V_{RMS}
150 VDC

Durchschlagsspannung

1000 V_{RMS}

Isolationswiderstand

10¹⁰ Ω

Durchgangswiderstand

≤ 10 mΩ

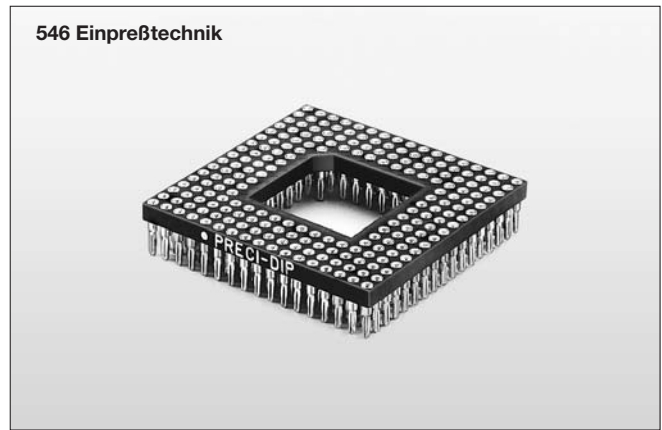
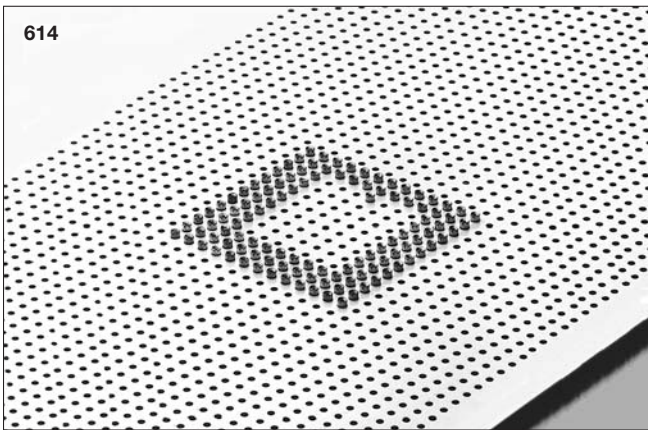
Luft- und Kriechstrecke



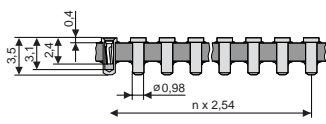
> 0,6 mm

Kapazität

< 0,3 pF

Finden Sie Ihr Layout nicht auf den Seiten
32.05 - 07, senden Sie uns bitte Ihr Bauteil.



614...112 Für Stift ∅ 0,4 bis 0,54 mm ▧ 0,25 x 0,45 mm	Hülse 	5 µm Zinn			5 µm Zinn	
	Feder 	0,25 µm Gold			0,75 µm Gold	
	Anzahl der Lamellen	Bestell-Nr.				
		3	614-91-XXX-XX-XXX-112		614-93-XXX-XX-XXX-112	
612...101 Für Stift ∅ 0,4 bis 0,56 mm ▧ 0,25 x 0,45 mm	6	612-91-XXX-XX-XXX-101		612-93-XXX-XX-XXX-101		
		D	F min.	F max.		
546...0XX Für Stift ∅ 0,4 bis 0,56 mm ▧ 0,25 x 0,45 mm	6	2,8	1,5	2,0	546-91-XXX-XX-XXX-036	
		3,8	2,1	3,2	546-91-XXX-XX-XXX-035	
					546-93-XXX-XX-XXX-036	
					546-93-XXX-XX-XXX-035	
XXX-XX-XXX = Layout (Seite 32.05 - 32.07)						